

锦州神工半导体股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与 实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《锦州神工半导体股份有限公司募集资金管理办法》的规定，将锦州神工半导体股份有限公司（以下简称本公司或公司）2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意锦州神工半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式，向特定投资者发行人民币普通股 10,305,736 股，每股发行价格为人民币 29.11 元，募集资金总额为人民币 299,999,974.96 元，扣除各项发行费用合计人民币 3,943,396.22 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 296,056,578.74 元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]110Z0012 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下：

项 目	金额（元）
募集资金净额	296,056,578.74
减：期初累计已使用募集资金的金额	169,046,798.15
减：本期已使用募集资金的金额	133,246,450.29
减：募集资金结余利息补充流动资金的金额	1,352.54
加：募集资金专项账户银行利息收入	6,238,022.24
募集资金专户余额	0
其中：募集资金专户余额	0
使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额	0

注：根据公司 2026 年 1 月 23 日第三届董事会第十一次会议、2026 年 2 月 10 日 2026 年第一次临时股东会会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募投项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”予以终止，公司已于 2026 年 3 月将节余募集资金 13,223.57 万元补充到公司银行存款账户。相关募集资金专户均已于 2026 年 3 月 13 日完成注销，因此截至报告期期末，募投项目已终止且募集资金已使用完毕并销户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理制度），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。

2023 年 9 月，公司、国泰海通证券股份有限公司与招商银行锦州分行营业

部、中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：元

银 行 名 称	银行账号	余额
招商银行锦州分行营业部	416900037710703	已注销，零余额
中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行	0708004329200669624	已注销，零余额
合 计		0

注：上述账户均已于 2026 年 3 月 13 日完成注销

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目情况

募集资金使用情况表详见本报告“附表：2023 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026 年 1-6 月，本公司不存在先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年 1-6 月，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2026 年 1-6 月，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币 11,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

截至2026年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：元

银行名称	产品名称	金额	起止期限	年化收益率	是否赎回
中国中金财富证券有限公司辽宁分公司	收益凭证（中金财富安享1044号）	40,000,000.00	2025-10-28 至 2026-03-04	1.63%	是
国泰海通证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部	收益凭证（君柜宝 2025 年第 18 期）	47,000,000.00	2025-10-28 至 2026-01-29	1.63%	是
国泰海通证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部	收益凭证（尧睿 25324 号）	23,000,000.00	2025-12-23 至 2026-03-04	1.66%	是

（六）结余募集资金使用情况

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司前次募集资金投资项目存在以下变更的情况：

根据公司 2026 年 1 月 23 日第三届董事会第十一次会议、2026 年 2 月 10 日 2026 年第一次临时股东会会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募投项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”予以终止，并将节余募集资金 13,223.57 万元永久补充流动资金。

2023 年公司决定实施“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”时公司综合考虑了当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素，经过充分论证制定的

项目投资计划。但随着半导体行业需求变化，外部环境较决策时已发生明显变化。全球和中国的市场环境较公司规划募投项目时已发生较大变化：一方面，由于全球半导体市场的结构性行情，导致市场整体景气度恢复的时间晚于公司最初预测，该业务的产能利用率未达预期；另一方面，中国本土存储芯片制造厂商发展迅猛，改变了既有的全球产业格局，公司大直径硅材料的直接下游产品硅零部件受到国产化需求带动，实现连续大幅增长，成为公司第二增长曲线，对公司水电气等基础设施配套以及人才梯队建设提出更高要求，需要资金投入。公司经综合考虑近年来市场的供需情况、行业竞争格局变化等因素，审慎决定不再继续投入原募投项目。“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”终止有利于合理利用募集资金，提高资金使用效率，不会对募投项目及公司生产经营活动产生重大不利影响。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：2023年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2026年8月27日

附表：

2023 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				29,605.66		本年度投入募集资金总额					13,324.64	
变更用途的募集资金总额				13,223.57		已累计投入募集资金总额					30,229.32	
变更用途的募集资金总额比例				44.67%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目	否	21,000.00	20,905.66	20,905.66	101.07	8,257.64	-12,648.02	39.50	见注释	不适用	不适用	是
2.补充流动资金	否	9,000.00	8,700.00	8,700.00	13,223.57	21,971.68	13,271.68	252.55	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	30,000.00	29,605.66	29,605.66	13,324.64	30,229.32	623.66	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					见注释							
募集资金其他使用情况					不适用							

注：根据公司 2026 年 1 月 23 日第三届董事会第十一次会议、2026 年 2 月 10 日 2026 年第一次临时股东会会议，审议通过《关于

终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募投项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”予以终止，公司已于 2026 年 3 月将节余募集资金 13,223.57 万元补充到公司银行存款账户。相关募集资金专户均已于 2026 年 3 月 13 日完成注销，截至 2026 年 3 月 31 日，募投项目已终止且募集资金已使用完毕并销户。